

良品解析事例 (Agワイヤ使用ICのパッケージ開封)

概要

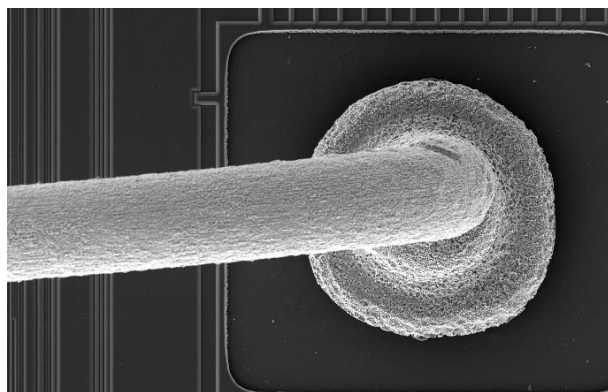
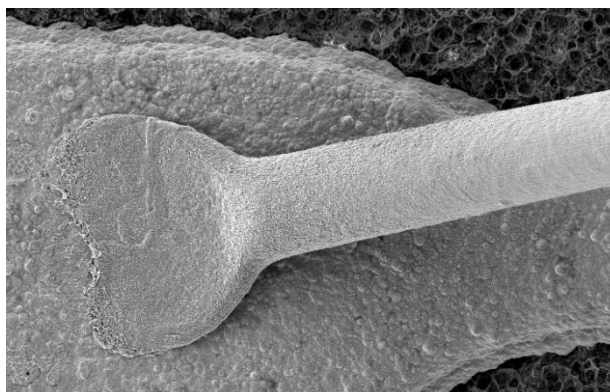
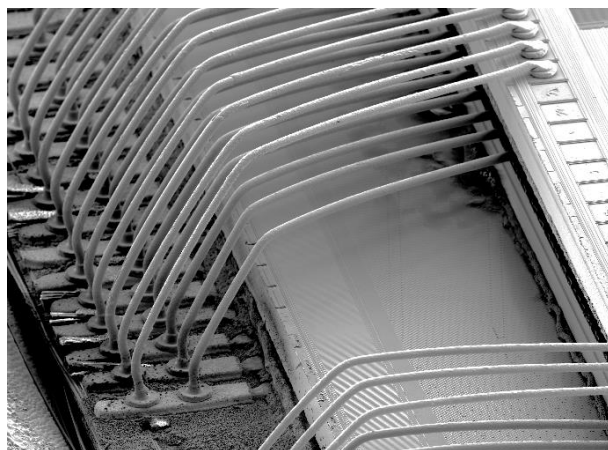
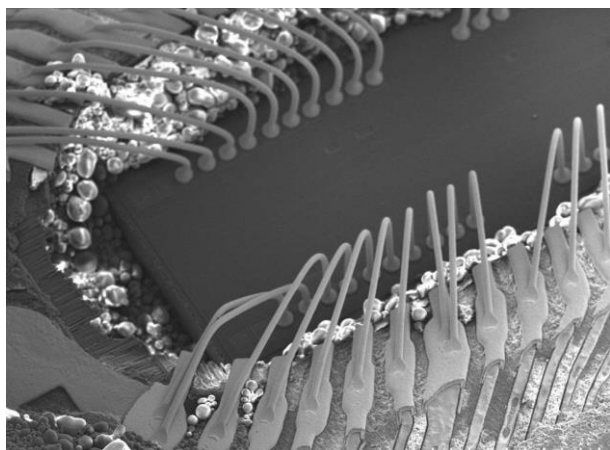
Agワイヤ使用ICの樹脂除去においては、ワイヤの薬品ダメージが大きいことが問題となります。当社では、飽和法※の原理を用い、ダメージを抑えたパッケージ開封方法の開発により、ボンディング形状の観察を可能といたしました。下記にご紹介いたします。

特徴

ワイヤ表面の観察、ボンディング状態の確認、エミッション観察の通電など、目的に合わせたパッケージ開封を行います。

(開封後のワイヤの状態は、樹脂種、ワイヤ種、形状等により程度が異なりますので、事前トライアルをお勧めしております)

樹脂除去後のワイヤー状態



※) 日本サイエンティフィック株式会社様の飽和法による。(http://www.nscnet.co.jp/j/index_j.html)

お問い合わせ先

ユーロフィンFQL株式会社 信頼性評価、環境試験、故障解析、品質保証サポート

<https://www.eurofins.co.jp/efql/contact>

9時～17時 土・日・祝日・当社指定の休業日を除く